

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-024

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月19日召开第五届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2025年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过37.8亿元人民币；其中，公司拟对子公司武汉精毅通信息技术有限公司（以下简称“武汉精毅通”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币2.5亿元，拟对上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币8.5亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。

公司分别于2025年10月28日、2025年11月17日召开第五届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司拟对上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币1亿元，授信品种：

流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-129）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，具体担保进展情况披露如下：

二、担保进展情况

为满足子公司武汉精毅通日常经营发展需要，公司近日与交通银行股份有限公司武汉洪山支行（以下简称“交通银行”）签订编号为“保A101HS26010”的《保证合同》，约定公司为武汉精毅通向交通银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行”）签订编号为“DB232260173”的《借款保证合同》，约定公司为上海精测向上海银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

为满足子公司上海精积微日常经营发展需要，公司近日与北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）签订编号为“6194835-001”的《最高额保证合同》，约定公司为上海精积微向北京银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

三、担保合同的主要内容

（一）《保证合同》（编号：保A101HS26010）

- 1、债权人：交通银行股份有限公司武汉洪山支行
- 2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
- 3、债务人：武汉精毅通电子有限公司
- 4、保证额度有效期自2026年2月28日起至2027年2月28日

5、保证最高本金限额为人民币：壹仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

8、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

（二）《借款合同》（编号：DB232260173）

1、债权人：上海银行股份有限公司闵行支行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：上海精测半导体技术有限公司

4、保证额度有效期自 2026 年 3 月 18 日起至 2028 年 2 月 28 日

5、保证最高本金限额为人民币：玖仟肆佰万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

8、保证期间：保证期间为履行债务的期限届满之日起 3 年。

（三）《最高额保证合同》（编号：6194835-001）

1、债权人：北京银行股份有限公司上海分行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：上海精积微半导体技术有限公司

4、保证额度有效期自 2026 年 3 月 16 日起至 2027 年 3 月 15 日

5、保证最高本金限额为人民币：伍仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/

仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。

8、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 96,976.96 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2024 年 12 月 31 日净资产的 28%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

- 1、《保证合同》；
- 2、《借款保证合同》；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年3月26日